

1-5-1-6 めっき面糊付着突起／鍍层面有胶迹的凸出／ Projected conductor by adhesive on plated surface

【特徴】銅めっき面と同一面の糊が引き伸ばされた様相の突起

【特征】在鍍銅面有胶被拉长模样的凸出。

【Characteristics】Conductor projection of the same height as that of the plated copper surface that appears to be formed by pressed and spreaded adhesive.

【原因・判断ポイント・発生工程】銅めっき表面に付着した糊がE Tレジストとなり、導体がE Tされずに出来たもの（DFRラミネート前～E T工程）

【原因、判断要点、发生工序】鍍銅面の胶迹成为ET剂，导线不被ET而引起的（DFR压膜前～ET工序）。

【Causes/processes involved/keys to judgment】Adhesive attached on the plated copper surface acts as an etching resist and conductor is left unetched causing the defect. (Abrasion before dry film lamination - etching process)



【コメント】糊の下にめっき銅箔が残って突起になっている（糊は除去済み）顕微鏡倍率×

【注釋】胶迹在电镀铜箔下面的凸出（已除去胶迹）显微镜倍率×

【Comments】Plated copper remains under adhesive and makes a projection (View after adhesive removal). Magnification: ×



【コメント】糊の下にめっき銅箔が残って突起になっている（糊は除去済み）顕微鏡倍率×

【注釋】胶迹在电镀铜箔下面的凸出（已除去胶迹）显微镜倍率×

【Comments】Plated copper remains under adhesive and makes a projection (View after adhesive removal). Magnification: ×

1-5-1-7 プリプレグ残り突起／B片屑の凸出／ Projected conductor by prepreg debris

【特徴】プリプレグが積層銅箔表面に残っている状態の突起

【特征】B片屑残留在层压铜箔表面的凸出。

【Characteristics】Conductor projection by prepreg debris remained on copper surface of a CCL.

【原因・判断ポイント・発生工程】積層工程で、外層銅箔面にプリプレグが圧着され、これがE Tレジストとなって出来たもの（多層板積層～E T工程）



【コメント】プリプレグの下に積層銅箔が残っている顕微鏡倍率×

【注釋】在B片下面的层压铜箔显微镜倍率×

【Comments】A part of copper foil remains under prepreg debris Magnification: ×